

贵研铂业股份有限公司

关于贵金属装联材料产业化项目立项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟投资标的名称：贵金属装联材料产业化项目
- 预估项目总投资金额：5.6亿元
- 风险提示：本项目尚处于立项阶段，能否通过审批存在不确定性，是否实施投资建设尚存在不确定性。项目具体投资方案尚未确定，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定具体投资方案，并另行履行董事会和股东大会（如需）审批程序且履行相应的信息披露义务。项目的实施符合国家政策法规，但建设方案尚需通过相关政府主管部门审批和备案。项目实施后，存在产品上市后受市场竞争格局和市场需求变化影响不能达成产品规划时预期目标的风险。

一、项目立项概述

本项目开发的贵金属装联材料产品主要包括以金基材料为主的贵金属键合丝、高纯贵金属蒸镀材料、溅射靶材三大类。由于贵金属装联材料具有优良的抗腐蚀、导电导热性、耐热冲击性强、封接强度高、焊接工艺性好、熔流点稳定等特点，是半导体行业中芯片制备、封装测试、功能性连接中关键基础材料，主要用于制备化合物半导体芯片、固态照明芯片，应用在 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网和固态照明等领域。

当前时期，公司面临国家大力发展半导体行业、全面实施国产化替代的良好政策环境，以及市场需求稳步增长的机遇；在市场需求牵引下，公司突破了高端集成电路(IC)用超细键合金丝批量化制备关键技术、选择性深度除杂-电位调控还原技术、集成电路用贵金属短流程清洁制备批量化工艺，开发了 IC 用超细键合金丝、集成电路用高清洁性蒸镀金和大尺寸、薄板、小晶粒靶材产品；为开发国内高端贵金属装联材料市场，实现国产替代，提供了良好的支撑，对完善行业产业链具有重要意义。

二、投资标的基本情况

（一）项目主要建设内容

1、预计规划用地 30 亩。

2、新建四个制造单元：贵金属键合丝制造单元、高纯贵金属蒸镀材料制造单元、溅射靶材制造单元、贵金属高纯原料制造单元，形成产品生产能力 26 吨/年，高纯贵金属原料配套能力 12 吨/年。

3、新建两个中心：贵金属装联材料研究与开发中心、贵金属装联材料分析与测试中心。

4、形成三大系列产品：贵金属键合丝、高纯贵金属蒸镀材料、溅射靶材。

5、新建生产车间，建设与配套的仓储、公辅、环保消防等设施。

（二）建设周期

本项目建设期预计 3 年。

（三）项目建设地点

昆明新城高新技术产业基地马金铺工业园区内。

（四）项目投资及收益

该项目预估总投资 5.6 亿元，投资额为初步预估金额，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定投资方案，并履行董事会、股东大会（如需）审批程序。

（五）董事会审议表决情况

2020 年 11 月 17 日，公司召开第七届董事会第十一次会议。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司贵金属装联材料产业化项目立项的议案》。

三、投资项目对上市公司的影响

（一）项目资金来源：公司自筹。

（二）本项目符合国家产业政策和公司贵金属产业规划、业务布局的实际需要。项目的实施将充分依托公司拥有自主知识产权的贵金属装联材料制备关键技术，实现产业化，解决公司产能不足和设备落后的现状，将进一步提升产品的生产能力，满足市场需求，增强公司在半导体行业领域的影响力和竞争力，为贵金属新材料产业长足发展提供支撑。

四、风险提示

（一）项目实施的风险

目前，本项目尚处于立项阶段，是否实施投资建设尚存在不确定性。项目具体投资方案尚未确定，后续公司尚需按照相关规定编制可行性研究报告，确定具体投资方案，并另行履行董事会和股东大会（如需）审批程序且履行相应的信息披露义务。

（二）项目审批的风险

本项目的实施符合国家政策法规，但建设方案尚需通过相关政府主管部门审批和备案，项目能否通过审批存在不确定性。

（三）市场风险

本项目实施后，存在产品上市后受市场竞争格局和市场需求变化影响不能达成产品规划时预期目标的风险。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、贵研铂业第七届董事会战略投资发展委员会第五次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2020年11月18日